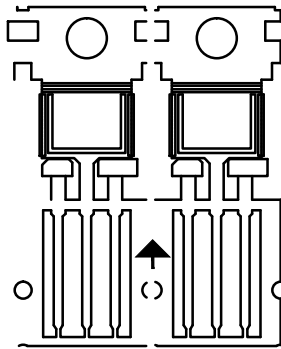
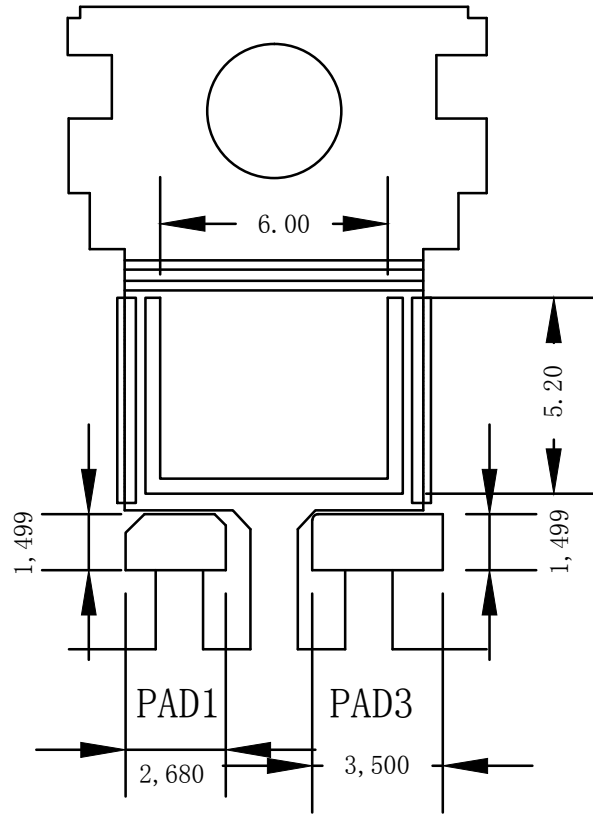


装片及键合配线图



| 产品信息 | | | | 装片信息 | | 键合信息 | |
|------|-----|------|----|----------|----|--|---------------|
| 封装形式 | | | | L/F型号 | | 总焊线数 | |
| 封装品名 | | | | 装片胶 | | Min. BPO (um) | |
| 芯片名称 | | | | | | | Min. BPP (um) |
| | | | | 芯片大小(um) | | 打线材质 | |
| | | | | 芯片厚度(um) | | 打线直径 | |
| | | | | 划片槽 (um) | | 打线直径 | |
| 版本 | 年月日 | 变更内容 | 拟制 | 审查 | 批准 | 铝层厚度(um) | |
| | | | | | | 图 号 | |
| | | | | | |  成都集佳科技有限公司 | |